



平成25年6月5日

各位

会社名 株式会社日立ハイテクノロジーズ
代表者 執行役社長 久田 眞佐男
(コード番号 8036 東証・大証第一部)
問い合わせ先 CSR・コーポレートコミュニケーション部長
加藤 弘之
(電話：03-3504-5138)

会社分割による分析装置事業の最適事業運営体制の構築について

当社は、分析装置事業の最適事業運営体制の構築を目的として、平成25年10月1日付けで、当社の分析装置事業の設計および国内販売機能を、簡易吸収分割により株式会社日立ハイテックスサイエンス（以下、日立ハイテックスサイエンス）に統合することを、5月23日開催の取締役会で決定いたしました。なお、本会社分割は100%子会社に事業を承継させる会社分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

1. 会社分割の目的

当社における分析装置事業の設計および国内販売機能を、日立ハイテックスサイエンスに統合することにより、当社の保有する分光分析、液体クロマトグラフ等の分析装置事業と、平成25年1月に新たに当社グループ会社となった日立ハイテックスサイエンスの保有する熱分析、蛍光X線分析等の分析装置事業とのシナジー効果の早期最大化を図り、分析装置事業の最適事業運営体制を構築いたします。

2. 会社分割の要旨

(1) 会社分割の日程

取締役会決議日	平成25年5月23日
契約締結日	平成25年7月(予定)
実施予定日(効力発生日)	平成25年10月1日(予定)

※本会社分割は、会社法第796第3項および同法第784条第3項に定める簡易吸収分割に該当するため、当社および日立ハイテックスサイエンスにおいて分割契約書の承認に関する株主総会を開催する予定はありません。

(2) 会社分割の方式

当社を吸収分割会社とし、日立ハイテックスサイエンスを吸収分割承継会社とする吸収分割です。

(3) その他

その他の会社分割の詳細については、決定次第公表します。

3. 会社分割の当事会社の概要(平成25年3月末現在)

	分割会社	承継会社
(1)名称	株式会社日立ハイテクノロジーズ	株式会社日立ハイテックスサイエンス
(2)所在地	東京都港区西新橋一丁目24番14号	東京都港区西新橋一丁目24番14号
(3)代表者の役職・氏名	執行役社長 久田 眞佐男	取締役社長 池田俊幸
(4)事業内容	電子デバイスシステム、ファインテックシステム、科学・医用システム的设计、製造、販売、および産業・ITシステム、先端産業部材の販売	分析装置、計測装置、観察装置的设计、製造、販売

(5)資本金	7,938 百万円	100 百万円
(6)設立年月日	昭和 22 年 4 月 12 日	平成 12 年 3 月 1 日 (平成 25 年 1 月 1 日より当社グループ会社)
(7)発行済株式数	137,738,730 株	60,000 株
(8)決算期	3 月末	3 月末
(9)従業員数	10,436 名 (連結)	304 名 (単独)
(10)大株主および持株比率	<ul style="list-style-type: none"> ・株式会社日立製作所 51.64% ・日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 4.15% ・日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) 4.12% ・日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口 9) 2.51% ・日立ハイテクノロジーズ社員持株会 1.69% 	株式会社日立ハイテクノロジーズ 100%
(11)直近事業年度の経営成績および財政状態		
純資産	267,189 百万円 (連結)	3,874 百万円 (単独)
総資産	433,639 百万円 (連結)	11,144 百万円 (単独)
1 株当たり純資産	1,939.81 円 (連結)	64,568 円 (単独)
売上高	575,468 百万円 (連結)	3,028 百万円※ (単独)
営業利益	18,951 百万円 (連結)	235 百万円※ (単独)
経常利益	20,098 百万円 (連結)	260 百万円※ (単独)
当期純利益	12,166 百万円 (連結)	337 百万円※ (単独)
1 株当たり当期純利益	88.45 円 (連結)	5,608.69 円※ (単独)

※上記「会社分割の当事会社の概要」に記載している日立ハイテクサイエンスの経営成績は、平成 25 年 1 月 1 日より当社グループ会社となったため、平成 25 年 1 月から 3 月までの 3 カ月分の経営成績を記載しております。

4. 分割または承継する事業部門の事業内容

(1) 分割または承継する部門の事業内容

分光分析、液体クロマトグラフ等の分析装置事業における設計および国内販売機能

(2) その他の分割または承継する事業部門の詳細については、決定次第公表します。

5. 会社分割後の状況

当社および日立ハイテクサイエンスの名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期については、いずれも分割による変更はありません。

6. 今後の見通し

当社の連結業績に与える影響は軽微です。

(参考) 当期連結業績予想 (平成 25 年 4 月 23 日公表分) および前期連結実績 (単位: 百万円)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	連結当期純利益
当期業績予想 (平成 26 年 3 月期)	640,000	28,000	28,000	19,700
前 期 実 績 (平成 25 年 3 月期)	575,468	18,951	20,098	12,166

以 上